

LITERATURA

- /1/ Surface Mounted Devices - Bauelemente, Bestückungs-
Verarbeitung, 1985/86. Firemní literatura firmy Valvo.
- /2/ Mappe SMD - Technik, Firemní literatura firmy Siemens AG.
B3-3413, Oktober 1986.
- /3/ ZELTWANGER, H.: SMD - Technik in kleineren und mittleren
Unternehmen. Eine Notwendigkeit mit Chancen und Schwierig-
keiten, Elektronik, 1985, č. 14, s. 42-70.
- /4/ LYMAN, J.: Surface Mounting Alters the PC-Board Scene.
Electronics, Feb. 9., 1984, s. 113-124.
- /5/ Surface-mount technology. Firemní literatura firmy Panaso-
nic Deutschland GmbH. 1985.
- /6/ KLASCHE, B.: Chip-Bauelemente schnell und zuverlässig
bestückt. Elektronik, 1983, č. 21, s. 118-124.
- /7/ HARTL, W.: Pin-Frame - kostengünstige Montage von Chip-
Carriern. Elektronik, 1984, č. 11, s. 86-91:
- /8/ KOLBECK, A.: Der Chip-Carrier. Elektronik, 1983, č. 11,
s. 93-98.
- /9/ Leiterplatten-Bestückung und Test, VDI-Berichte 519,
Düsseldorf, 1984.
- /10/ BEEDIE, M.: Surface-mounted Packaging. Electronic design,
1985, č. 1, s. 232-250.
- /11/ COGGINS, R.: Lötén in der Dampfphase. Markt & Technik,
Sonderausgabe April, SMD: Eine Technologie an der Schwelle
zum Erfolg, s. 46-47.
- /12/ MAIWALD, W.: SMD-Technik - Einführung in die Oberfläche
montage., Siemens AG, 1985 (nezveřejněno).
- /13/ Katalogy součástek firem Siemens AG, Valvo, ITT, Panasonic,
Murata, Rohm, Thompson, Ferranti.
- /14/ JOHNSON, P. G.: Cleaning Surface Mounted Assemblies,
Electronic Production. November/December 1985, s. 27-30.
- /15/ SMD - Technik, Einführung in die Oberflächemontage.
Firemní literatura Siemens AG. 1984.
- /16/ Bestückautomat für Chip und planare Bauelemente. Firemní
literatura Siemens AG. 1984.
- /17/ WARD, D.: High Volume Surface Mount Technology. Circuits
Manufacturing. March 1985, s. 58-72.
- /18/ WASSIVK KLEIN, R. J. - VLEDDER, H. J.: The Attachment of
Leadless Electronic Components. Hybrid Circuits, No. 3,
Autumn 1983, s. 28-32.

- /19/ SCHMITTER, D.: MIKROPACK - Oberflächenmontage ohne Kompromisse, Siemens Components, 24, 1986, č. 6, s. 227-228.
- /20/ SCHÖNLEBE, G.: Lötten von SMD auf Leiterplatten, Siemens Components, 24, 1986, č. 6, s. 229-234,
- /21/ BESELIN, K. - SCHANFLINGER, H.: Testen von Flachbaugruppen mit SMD, Siemens Components, 24, 1986, č. 6, s. 242-246.
- /22/ NOVOTNÝ, J.: Technologie povrchové montáže součástek bez vývodů. Slaboproudý obzor, 47, 1986, č. 8, s. 391-399.
- /23/ NOVOTNÝ, J.: Materiály desek plošných spojů pro povrchovou montáž součástek. Slaboproudý obzor, 47, 1986, č. 9, s. 448-453.
- /24/ NOVOTNÝ, J.: Plošná montáž součástek (technologie SMD). Quo vadis elektronika '85, s. 350-358, TESLA-VÚST 1984.
- /25/ NOVOTNÝ, J.: Technologie povrchové montáže součástek. Quo vadis elektronika '86, s. 381-396, TESLA-VÚST 1985.
- /26/ NOVOTNÝ, J.: Technologie SMD ve vybraných oborech elektrotechniky. Quo vadis elektronika '87, s. 348-355, TESLA-VÚST 1986.
- /27/ ENGELMAIER, W.: Effect of Power Cycling on Leadless Chip Carrier Mounting Reliability and Technology. Electronic Packaging Production, April 1983, s. 58-63.
- /28/ MARKSTEIN, W.: Surface-Mount Substrates: The Key in Going Leadless. Electronic Packaging Production, June 1983, s. 50-55.
- /29/ LASSEN, C.: Wanted: a new interconnection technology. Electronic, September 27, 1979, s. 113-121.
- /30/ Einführung in die Technik der Surface Mounted Device ("Chip-technik"). Firemní literatura Contact-systems Ltd.
- /31/ WALTON, J.: Reacting to the Challenge of Surface Mounting. Electronic Production, September 1984, s. 29-33.
- /32/ HOLDWAY, J.: Guide for Removal, Replacement of Surface Mounted Devices - Part 2. Electronics, January 1985, s. 23-26, Part 3, Electronics, February 1985, s. 23-26.
- /33/ SMD-Technik. Firemní literatura firmy Fela. 8/1986.
- /34/ Surface Mounted Packaging. Firemní literatura Texas Instruments, 1984.